

UHU® PLUS ENDFEST 300

ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE, ESTREMAMENTE FORTE, UNIVERSALE, SENZA SOLVENTI.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo epossidico bicomponente, estremamente forte, universale, senza solventi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto per l'incollaggio di metallo, pietra, cemento, porcellana, legno, vetro, molti materiali sintetici. Ideale per giunture (industriali), che devono soddisfare i requisiti più elevati, come ingegneria elettrica, lavorazione di metalli e automazione. Non indicato per l'incollaggio di PE, PP, PTFE, polistirene e PVC flessibile.

PROPRIETÀ

- Forza di adesione finale estremamente elevata (300 kg/cm²)
- Estremamente resistente
- Antiurto
- Riempitiva
- Resistente all'acqua
- Resistente agli agenti atmosferici
- Senza solventi
- Resistente a molti solventi, acidi diluiti e alcali
- Può essere carteggiato, limato, forato e verniciato dopo la polimerizzazione
- Dotato di approvazione UL

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Utilizzare solo a temperature comprese tra +15 °C e +25 °C e con umidità massima del 65%.

Per impedire la formazione di bolle per condensazione, la temperatura dell'adesivo e dei materiali da incollare dovrebbe essere la stessa della temperatura ambiente e preferibilmente tra +18°C e +20°C.

Elabora in uno spazio libero da correnti.

Temperature inferiori a +18°C rallentano il processo di polimerizzazione e riducono la forza di adesione. In condizioni di freddo e all'aria aperta è necessario servirsi di un riscaldatore. Una maggiore forza di adesione finale si ottiene quando il processo di polimerizzazione avviene a temperature elevate fino a un massimo di 180°C.

Protezione personale: Si consiglia di indossare guanti di gomma o di plastica.

Requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere asciutti, puliti e privi di grasso.

Trattamento preliminare delle superfici: Pulire accuratamente le superfici prima di incollarle, ad esempio, con acetone. A seconda della superficie, irruvidire le parti da incollare con, per esempio, carta abrasiva a grana fine.

Utensili: UHU Plus Endfest 300 pistola e UHU Plus beccucci miscelatori

APPLICAZIONI

Rapporto di miscelazione: 1:1 (in volume)

Posizionare la doppia siringa nella pistola UHU Plus. Rimuovere il cappuccio della

doppia siringa e montare il beccuccio miscelatore. Applicare l'adesivo su un lato o su entrambi in caso di superfici ruvide. Successivamente unire le parti tra loro. Dopo l'uso, rimuovere il beccuccio miscelatore e richiudere la cartuccia con il cappuccio.

Tempo aperto: 90 minuti

Macchie/Residui: Rimuovere immediatamente i residui di adesivo bagnato con acqua calda e sapone. I residui di adesivo secco possono essere rimossi solo meccanicamente.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Tempo di asciugatura/polimerizzazione: ca. 90 minuti

Forza finale dell'incollaggio dopo: ca. 12 ore

Afschuifsterkte UHU Plus endfest 300

Résistance au cisaillement UHU Plus endfest 300

Temperatuur Température	Uithardingstijd Temps de séchage	Eindsterkte ¹ Résistance finale ¹
20°C	12 uur	± 1200 N/cm ²
40°C	3 uur	± 1800 N/cm ²
70°C	45 min	± 2000 N/cm ²
100°C	10 min	± 2500 N/cm ²
180°C	5 min	± 3000 N/cm ²

¹Afschuifsterkte aluminium-aluminium

¹Résistance au cisaillement aluminium-aluminium

UHU[®]

PLUS ENDFEST 300

**ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE, ESTREMAMENTE FORTE,
UNIVERSALE, SENZA SOLVENTI.**

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona

Resistenza all'acqua: Buona

Resistenza alle temperature: -40°C - +100°C

Resistenza ai raggi UV: Molto buona

Resistenza alle sostanze chimiche: Molto buono

Verniciabilità: Buono

Potere riempitivo: Molto buono

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto: Legante: opaco ad alta viscosità; indurente: color miele a media viscosità

Base chimica: Legante: resina epossidica; indurente: ammine alifatiche

Tecnica d'incollaggio: Applicazione su 1 lato

Consistenza: Liquido

Viscosità: ca. 35.000 mPa.s., Liquido

Residuo secco: ca. 100 %